## 顕微PL法とEL法によるPERC断面の発光観察 Cross Section Luminescence Images of PERC by Micro PL and EL アイテス<sup>1</sup>,産業技術総合研究所<sup>2</sup><sup>○</sup>高野和美<sup>1</sup>,山下勝<sup>1</sup>,白澤勝彦<sup>2</sup>,高遠秀尚<sup>2</sup> ITES Co. Ltd.<sup>1</sup>, National Institute of Advanced Industrial Science and Technology<sup>2</sup> <sup>°</sup>Kazumi Takano<sup>1</sup>, Masaru Yamashita<sup>1</sup>, Katsuhiko Shirasawa<sup>2</sup>, Hidetaka Takato<sup>2</sup> E-mail: kazumi\_takano@ites.co.jp

結晶シリコン型太陽光発電素子である PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) は、裏面側に絶 縁層 (Passivation Layer)を形成するセル構造であり、従来の裏面障壁 (AI-BSF) 構造に比べて結 晶裏面側での少数キャリアの表面再結合速度を抑制する特長がある。本報告では、PERC 製造工 程中のセルを樹脂封止後、研磨により断面を作製し、顕微鏡下でセル表面側から励起光を照射し PL (Photo-Luminescence) 像を得た。同時に表面銀電極部と裏面アルミ電極部にプローブコンタク トし EL (injection Electro-Luminescence) 像を観察して、表面再結合速度の相違の可視化を試みた。



Fig. 1. PL images of three samples at room temperature

上図の左のLCO 試料断面は、絶縁層に電極貫通孔を形成したため、孔の表面再結合速度が大き くなり、孔を中心として同心円状に裏面側のPL 強度が弱くなったと考えられる。中央のLocal BSF が形成後の試料では、電極貫通孔の表面再結合速度が抑制された効果で、電極貫通孔周辺のPL 強度の低下が改善されたと考えられる。右の表面銀電極試料断面は、銀電極が形成される過程で SiN 層に貫通孔を生じ、銀電極部の表面再結合速度が大きくなり、周辺のPL 強度が弱くなったと 考えられる。また、EL 画像では、両側電極部から多数キャリアを多量に注入するため、表面再結 合速度の影響を受けにくく、Local BSF 近傍を除けば上下方向に EL 強度の分布が見られない。こ れは、PL と EL の発光過程による違いである。逆バイアス EL 画像では、セル表面位置(PN 接合 部と考えられる)にホットエレクトロンの発光が認められ、Local BSF 付近にも発光がある。